

SiCウェーハ用高性能研磨スラリー

NANOBITM

用 途

- ・ SiCウェーハ用、2液混合型研磨スラリー

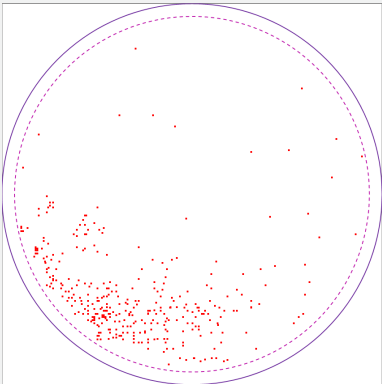
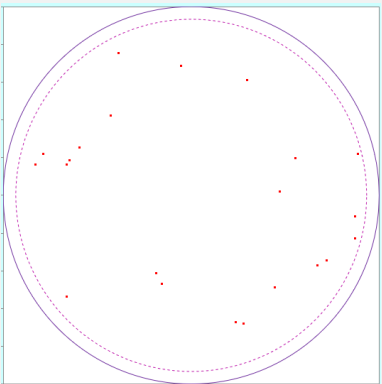
概要・特徴

- ・ MnO₂砥粒により1工程で高速かつ低ダメージで加工が可能
- ・ C面とSi面のレート差を抑えて加工可能
- ・ 装置洗浄/ウェハ洗浄が容易
- ・ 循環で使用可能



A液

B液

	市販のエピレディウェーハ	NANOBI TM 研磨後ウェーハ
潜傷マップ※		
潜傷密度	158 (/cm ²)	10(/cm ²)

※ミラー電子顕微鏡による評価(日立ハイテック社製Mirelis VM1000)